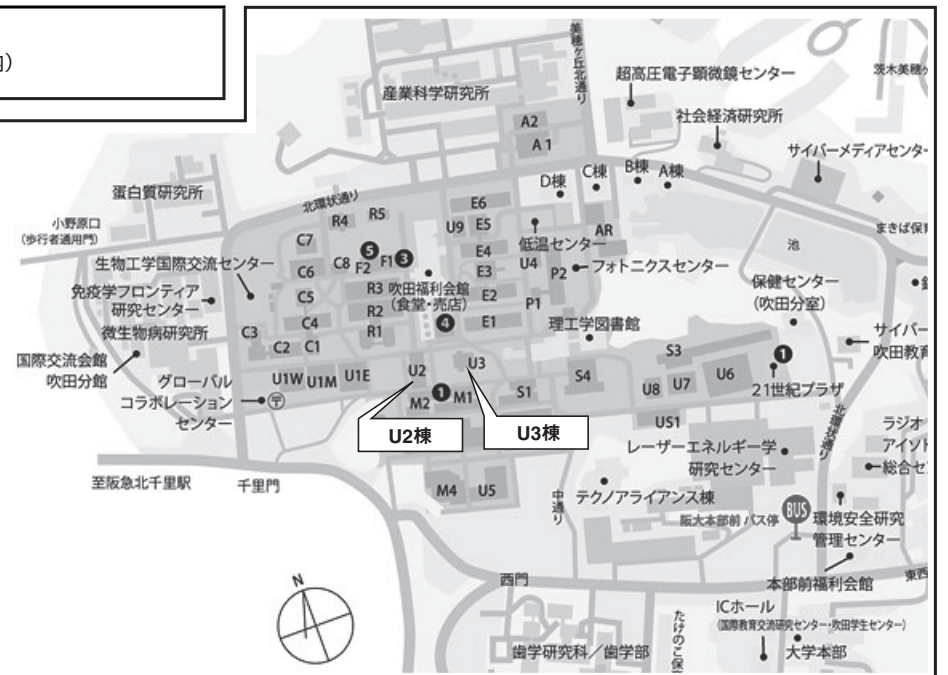


	A会場	B会場	C会場	D会場
10:00	<p><b>[1A1] パワエレ-1 高熱伝導材料1</b></p> <p>1. SiC パワーデバイスの実装技術と実装材料の開発動向 ○宮代文夫(よこはま高度実装技術コンソーシアム) (依頼講演 40分)</p> <p>2. CNT-CF ネットワークを利用したアルミニウム基高熱伝導複合材料 ○佐々木克彦<sup>1</sup>, 片桐一彰<sup>2</sup>, 伊藤洋平<sup>2</sup>, 永井明夫<sup>2</sup>, 高橋教雄<sup>2</sup>, 垣辻 篤<sup>3</sup> (北海道大学, <sup>2</sup>TASC/住友精密工業, <sup>3</sup>大阪府立産業技術総合研究所)</p> <p>3. カーボンファイバーを垂直配向制御させた高熱伝導シート ○内藤寛樹, 三宅雅哉, 迫 康浩, 畑 克彦 (バンドー化学)</p> <p>4. パワーデバイスにおける熱境界条件の決定方法と寿命評価に関する研究 ○齋藤良信 (横浜国立大学)</p>	<p><b>[1B1] 最先端材料</b></p> <p>1. ビスマスめっき成膜を用いた高温鉛フリーはんだ接合の開発 ○中村太一, 北浦秀敏, 古澤彰男, 酒谷茂昭 (パナソニック)</p> <p>2. 熱可塑性樹脂被覆による金属フィラー含有エポキシ樹脂のハイブリッド化とその実装性 ○福本信次, 脇元亮一, 山本悠斗, 松嶋道也, 藤本公三 (大阪大学大学院)</p> <p>3. エポキシ/銀コンポジットの電気的・熱的特性に及ぼす樹脂特性の影響 ○入船 晃<sup>1</sup>, 越智光一<sup>1</sup>, 原田美由紀<sup>1</sup>, 古正力亜<sup>2</sup>, 近藤剛史<sup>2</sup> (関西大学, <sup>2</sup>田中貴金属工業)</p> <p>4. 印刷工法で作製した伸縮性配線における Mullins 効果の発現と回復現象 ○井上雅博, 多田泰徳, 板橋洋介 (群馬大学)</p> <p>5. バインダケミストリに着目した導電性接着剤の微細組織制御 ○井上雅博<sup>1</sup>, 多田泰徳<sup>1</sup>, 牟田浩明<sup>2</sup>, 山中伸介<sup>2</sup> (群馬大学, <sup>2</sup>大阪大学大学院)</p>	<p><b>[1C1] 高速高周波・電磁特性技術-1 アンテナ特性</b></p> <p>1. プリント配線板へ実装をしたスリット付広帯域アンテナの放射特性 ○櫻井 佑, 山本隆彦, 越地耕二 (東京理科大学)</p> <p>2. 電子機器内蔵を考慮した折り曲げ型 UWB アンテナ放射パターン検討 ○百瀬大祐, 越地耕二, 山本隆彦 (東京理科大学)</p> <p>3. 左手導波管を用いたミリ波帯スロットアレーアンテナ—キャパシタ装荷による放射指向性制御の検討— ○小松真奈, 山本隆彦, 越地耕二 (東京理科大学大学院)</p> <p>4. 扇形台形不平衡ダイポールアンテナのフレキシブル化の検討 ○平栗一也<sup>1</sup>, 越地福朗<sup>1</sup>, 越地耕二<sup>2</sup> (国士館大学, <sup>2</sup>東京理科大学)</p> <p>5. 人体手部を考慮した第3世代移動通信および UWB 通信に対応するスマートフォン内蔵アンテナの電磁界解析 ○秋山佑祐<sup>1</sup>, 越地福朗<sup>1</sup>, 越地耕二<sup>2</sup> (国士館大学大学院, <sup>2</sup>東京理科大学)</p>	<p><b>[1D1] ものづくりセッション-1</b></p> <p>1. 純水リンス不要な非ハロゲン系低 VOC 一液フラックス洗浄システム 神保拓郎 (化研テック)</p> <p>2. Si 構造物の内部検査を可能にする外観検査装置 INSPECTRA-IR 鈴木一嘉 (東レエンジニアリング)</p> <p>3. 数案アートの加工技術 大橋一道 (大橋製作所)</p> <p>4. TSV/3D 実装高スルーボット多軸 TCB (Thermo Compression Bonding) 装置, HTB-6 白鳥俊幸 (アルファデザイン)</p> <p>5. 半導体デバイスへの適用が広がるコンプレッションモールド技術 大西洋平 (TOWA)</p> <p>6. 定常法による熱伝導率測定結果の傾向検討健一 (レスカ)</p> <p>7. 電子機器実装用低温・短時間硬化接着剤 徳平英士 (富士通クオリティ・ラボ)</p> <p>8. インクジェットプロセス開発用単ノズルヘッド 矢部雄一 (クラスターテクノロジー)</p>
11:40	<p><b>[1A2] パワエレ-2 高耐熱接合1</b></p> <p>1. 高信頼性パワーモジュール ○柴原良裕 (三菱電機) (依頼講演 40分)</p> <p>2. 低温接合可能な銀ナノ粒子ペーストによる半導体素子の無加圧接合 ○渡辺智文, 武居正史, 下山賢治, 松居美紀, 中島尚耶 (バンドー化学)</p> <p>3. 銀ナノペーストと AlN 基板との接合信頼性評価 ○栗田 哲<sup>1</sup>, 遠藤圭一<sup>1</sup>, 三好宏昌<sup>1</sup>, 砂地直也<sup>2</sup>, 小山内英世<sup>2</sup> (DOWA エレクトロニクス, <sup>2</sup>DOWA パワーデバイス)</p>	<p><b>[1B2] 先端検出・計測システム</b></p> <p>1. パターンレス1層タッチパネルシステムの開発 ○秋山 豊<sup>1</sup>, 佐藤陽一<sup>1</sup>, 橋本 薫<sup>1</sup>, 目黒弘一<sup>2</sup>, 大塚寛治<sup>1</sup> (明星大学, <sup>2</sup>JJTech)</p> <p>2. ワイヤグリッド偏光子を集積した小型偏光センサ ○日暮崇治<sup>1</sup>, 北島和典<sup>1</sup>, 山本道貴<sup>1</sup>, 須賀唯知<sup>1</sup>, 小口寿明<sup>2</sup> (東京大学, <sup>2</sup>日本精工)</p> <p>3. 部品内蔵基板用静電容量型検査システムの開発 ○野口祐智 (東京電機大学)</p> <p>4. 部品内蔵基板における受動部品の高精度な RF 計測技術開発 ○劉 佳, 田中雅也, 相楽秀次 (大日本印刷)</p>	<p><b>[1C2] 高速高周波・電磁特性技術-2 伝送技術</b></p> <p>1. EBG 構造を有する電源層における伝導性電磁雑音の低減特性改善に関する検討 ○増井智大, 越地耕二, 山本隆彦 (東京理科大学)</p> <p>2. プリントバイラルコイルとシンプルループコイル間の結合特性の検討 ○今野宗一郎, 山本隆彦, 越地耕二 (東京理科大学)</p> <p>3. 円形コイルと楕円型コイルを用いたワイヤレスエネルギー伝送の検討 ○堀米滉平<sup>1</sup>, 越地福朗<sup>1</sup>, 越地耕二<sup>2</sup> (国士館大学大学院, <sup>2</sup>東京理科大学)</p> <p>4. 据え置き型人体通信機器における電極入力インピーダンスの検討 ○黒子美咲<sup>1</sup>, 越地福朗<sup>1</sup>, 越地耕二<sup>2</sup> (国士館大学, <sup>2</sup>東京理科大学)</p>	<p><b>[1D2] ものづくりセッション-2</b></p> <p>1. 部品内蔵基板設計対応 CAD/CAM 技術と FUJIKO への期待 松澤浩彦 (図研)</p> <p>2. 部品内蔵基板の設計における CAD ツールの課題と対応 松岡宏志, 白鳥高之, 布施 武 (ワイ・ディシー)</p> <p>3. ガラスインターポーザーでのめっき被膜密着性の基礎特性評価 仙波幸治 (アトテック・ジャパン)</p> <p>4. 全湿式メタライズ2層 FCCL 製造プロセス;ELFSEED 福本ユリナ (JCU)</p> <p>5. 除熱剤 ヒートパスター 梶田雄三 (PDM)</p> <p>6. セミアクティブ対応微細配線形成材料 (PF-EL,AirFoil) 小野関仁 (日立化成)</p> <p>7. デンソーの PALAP 超高多層基板 横地智宏 (デンソー)</p> <p>8. 低誘電特性 接着フィルム ADFLEMA 吉田真樹 (ナミックス)</p>
12:40				
14:00	ものづくりコアタイム			
15:00	U3棟 211			
15:00	<p>MES2012 表彰式 ・ベストペーパー賞 ・研究奨励賞</p>			
15:20	<p>招待講演 1. 鴻海精密工業の昨日・今日・明日 (仮題) 中川威雄氏 (ファインテック) 2. 電子デバイス実装における研究開発の展開と課題-微細接合を中心に- 藤本公三教授 (大阪大学)</p>			
17:20	<p>招待講演: U3 棟 211 A 会場: U2 棟 311 B 会場: U2 棟 312 C 会場: U2 棟 213 D 会場: U2 棟 214 大学研究室/ものづくり展示コーナー U2 棟 212</p>			

17:30  
19:30  
交流会  
会場: ラ・シェーナ (大阪大学構内)



	A会場	B会場	C会場	D会場
9:00	<p><b>[2A1] プリンタブルエレクトロニクス</b></p> <p>1. ナノ粒子ペースト印刷によって透明電極を直接形成した GaN 系発光ダイオード ○柏本行康<sup>1</sup>, 小泉 敦<sup>2</sup>, 竹村康孝<sup>3</sup>, 垣内宏之<sup>4</sup>, 古田晋也<sup>5</sup>, 山本真理<sup>1</sup>, 齊藤大志<sup>1</sup>, 高橋雅也<sup>1</sup>, 大野敏信<sup>1</sup>, 藤原康文<sup>2</sup>, 村橋浩一郎<sup>2</sup>, 大塚邦顕<sup>2</sup>, 青柳伸宜<sup>4</sup>, 吉田幸雄<sup>4</sup>, 中許昌美<sup>1</sup> (大阪市立工業研究所, <sup>2</sup>大阪大学大学院, <sup>3</sup>奥野製薬工業, <sup>4</sup>大研化学工業, <sup>5</sup>巴製作所)</p> <p>2. ポリイミドフィルムへの密着性に優れた高精密銅パターン形成プロセスの開発 ○白髪 潤, 富士川亘, 村川 昭, 齊藤公恵, 義原 直 (DIC)</p> <p>3. パラジウム触媒を含んだシルセスキオキサン薄膜上への無電解めっきの形成 ○手嶋彩由里<sup>2</sup>, 御田村紘志<sup>1</sup>, 渡瀬星児<sup>1</sup>, 村橋浩一郎<sup>2</sup>, 松川公洋<sup>1</sup> (大阪市立工業研究所, <sup>2</sup>奥野製薬工業)</p> <p>4. プリンタブルエレクトロニクスに適した無電解めっき ○森口 朋, 本間秀和, 姜 俊行 (奥野製薬工業)</p>	<p><b>[2B1] 部品内蔵基板-1</b></p> <p>1. 新たな展開が見られる部品内蔵基板の動きを探る ○本多 進 (サーキットネットワーク) (依頼講演 40分)</p> <p>2. 部品内蔵基板の信頼性評価について ○加藤義尚, 堀内 整, 韓 榮建, 宗真太郎, 崔 雲, 友景 肇 (福岡大学)</p> <p>3. 薄膜キャパシタ内蔵インターポータ ○服部篤典, 小川裕裕 (野田スクリーン)</p>	<p><b>[2C1] 3次元 IC パッケージ</b></p> <p>1. 3次元 LSI チップ積層に用いる円錐マイクロパンプに対応した3次元形状光学測定手法の開発 ○青柳昌宏<sup>1</sup>, 渡辺直也<sup>1</sup>, 鈴木基史<sup>1</sup>, 菊地克弥<sup>1</sup>, 根本俊介<sup>1</sup>, 有馬典明<sup>2</sup>, 石塚 岬<sup>2</sup>, 鈴木康司<sup>2</sup>, 塩見俊夫<sup>2</sup> (産業技術総合研究所, <sup>2</sup>ソフトワークス)</p> <p>2. 3次元チップ実装用アンダーフィルフィルムによるボイドレス圧着の可能性検討 ○森山浩伸, 斎藤崇之, 小山太一, 増淵広和, 蟹澤土行 (デクセリアルズ)</p> <p>3. 3次元デバイス積層パッケージの評価解析: 熱応力とエレクトロマイグレーション ○小原さゆり, 堀部晃啓, 末岡邦昭, 松本圭司, 森 裕幸, 折井靖光 (日本アイ・ピー・エム)</p>	<p><b>[2D1] 先端インターコネク-1</b></p> <p>1. 低圧プラズマによる自己還元性生体インテラス材料の階層的表面改質 ○安田清和 (大阪大学)</p> <p>2. a-Si, a-Ge 薄膜を用いたウエハの室温接合と接合性能 ○魚本 幸, 今 一恵, 島津武仁 (東北大学)</p> <p>3. Injection Molded Solder 技術を用いた微細開口へのはんだバンピング技術 ○鳥山和重, 青木豊茂, 森 裕幸 (日本アイ・ピー・エム)</p> <p>4. リフロープロファイル予測手法の開発 ○岩田 彩, 田邊 剛, 朝山真次, 出田吾朗, 小山雅弘 (三菱電機)</p>
10:20	<p><b>[2A2] パワエレ-3 高熱伝導材料 2</b></p> <p>1. 高放熱性高分子材料開発の現状とこれから ○上利泰幸 (大阪市立工業研究所) (依頼講演 40分)</p> <p>2. シート状エポキシ樹脂によるウエハレベルパッケージ及び大面積パネル封止への展開について ○上野健一, 土肥一博, 石川有紀 (サンキュレック)</p> <p>3. B-N 粒子表面の高度修飾と、その複合エポキシ樹脂の特性 ○上利泰幸<sup>1</sup>, 平野 寛<sup>1</sup>, 門多丈治<sup>1</sup>, 岡田哲周<sup>1</sup>, 福井誠一<sup>2</sup>, 中村吉伸<sup>2</sup> (大阪市立工業研究所, <sup>2</sup>大阪工業大学)</p>	<p><b>[2B2] 部品内蔵基板-2</b></p> <p>1. めっき接続を用いた部品内蔵配線板の実用化に向けた取り組みと今後の課題 ○戸田光昭 (メイコー) (依頼講演 40分)</p> <p>2. ポリイミドフィルム積層型部品内蔵モジュール基板 ○中尾 知, 南條宏和, 板橋 敦, 宗像浩次, 岡本誠裕 (フジクラ)</p> <p>3. チップ埋め込み型三次元パッケージ WFOPTM ○高橋知子, 勝又章夫, 澤地 茂, 山方 修, 井上広司, 榎本 實 (ジェイデバイス)</p>	<p><b>[2C2] 高速高周波・電磁特性技術-3 高効率・高度化モデル</b></p> <p>1. 10Gbps 超の高速信号伝送向けインターコネク最適化技術 ○北井 敦, 齋藤賢一, 神 吉廣, 齊藤久志, 笹島正夫 (沖電気工業)</p> <p>2. 5GHz 帯高効率 PA のモジュール化に向けた協調解析および実証実験 ○内田祐介<sup>1</sup>, 宮川晃尚<sup>1</sup>, 金谷晴一<sup>2</sup> (中央電子工業, <sup>2</sup>九州大学大学院)</p> <p>3. 電磁界解析によるキャパシタ内蔵インターポータの超広帯域・超低電源ネットワークインピーダンス評価 ○菊地克弥, 青柳昌宏 (産総研)</p> <p>4. 分散容量結合による正帰還コイル: 人体通信用電界センサの高感度化 ○加藤康男, 佐久田博司 (青山学院大学)</p>	<p><b>[2D2] 先端インターコネク-2</b></p> <p>1. プラチナ触媒を用いた硝酸ガスによる銅の直接接合 ○赤池正剛, Yang Wenhua, 須賀唯知 (東京大学)</p> <p>2. 銀ダイレクトボンディングにおける接合条件の最適化 ○呉 哲哉, 長尾至成, 菅原 徹, 菅沼克昭 (大阪大学)</p> <p>3. 金属微粉末を用いた低温焼結接合技術と製造装置の開発 ○倉持 謙, 須賀唯知<sup>1</sup>, 白鳥俊幸<sup>2</sup>, 水越正孝<sup>3</sup> (東京大学, <sup>2</sup>アルファデザイン, <sup>3</sup>SYNDEO)</p> <p>4. 銀粒子の解こう剤による等方導電性接着剤 (ICA) の導電性への影響 ○小日向茂<sup>1</sup>, 寺尾あかり<sup>1</sup>, 白木義彦<sup>1</sup>, 井上雅博<sup>2</sup>, 上西啓介<sup>1</sup> (大阪大学, <sup>2</sup>群馬大学)</p>
11:50	ものづくりコアタイム			
11:50	ものづくりコアタイム			
12:20	ものづくりコアタイム			
13:20	<p><b>[2A3] パワエレ-4 高耐熱接合 2</b></p> <p>1. パワー半導体モジュールにおけるパッケージ・実装技術 ○池田良成, 望月英司, 高橋良和 (富士電機) (依頼講演 40分)</p> <p>2. 放熱用金属バルク材と電子デバイス用ウエハの大気中低温接合技術の開発 ○今 一恵, 魚本 幸, 島津武仁 (東北大学)</p> <p>3. 耐高温接合材によるダイボンド技術の開発 ○下田将義<sup>1</sup>, 山川智弘<sup>2</sup>, 堀川国夫<sup>1</sup>, 西川 宏<sup>2</sup>, 竹本 正<sup>2</sup>, 中谷誠登<sup>3</sup>, 後藤英之<sup>3</sup> (富士電機, <sup>2</sup>大阪大学, <sup>3</sup>ハリマ化成)</p> <p>4. 超耐熱 Zn-0.1Cr はんだと Cu 及び Ni 基板の界面反応 ○朴 聖源, 長尾至成, 菅原 徹, 菅沼克昭 (大阪大学)</p>	<p><b>[2B3] めっき技術-1</b></p> <p>1. プリント配線板のはんだ付け性向上を目的とした新規無電解パラジウムめっきプロセスの開発 ○亀井 勝<sup>1</sup>, 渋谷宏明<sup>1</sup>, 珍田 聡<sup>1</sup>, 小林弘典<sup>2</sup>, 大内高志<sup>2</sup>, 伊森 徹<sup>2</sup> (JX 金属商事, <sup>2</sup>JX 日鉱日石金属)</p> <p>2. はんだボール接続信頼性に及ぼす表面処理とはんだの影響 ○江尻芳則<sup>1</sup>, 納堂高明<sup>1</sup>, 赤井邦彦<sup>1</sup>, 中川昌之<sup>1</sup>, 渡辺 靖<sup>1</sup>, 榎本奈々<sup>1</sup>, 櫻井健久<sup>1</sup>, 荒山貴慎<sup>2</sup>, 廣山幸久<sup>1</sup>, 長谷川清<sup>1</sup> (日立化成, <sup>2</sup>日立化成テクノサービス)</p> <p>3. プリント基板用無電解 Ni/Ag めっきプロセスの検討 ○青木智美<sup>1</sup>, 工藤喜美子<sup>1</sup>, 田邊靖博<sup>1</sup>, 細野秀美<sup>2</sup> (奥野製薬工業, <sup>2</sup>甲南大学)</p> <p>4. Au ワイヤボンディング実装に優れた無電解 Ag めっきプロセスの開発 ○藤森友之<sup>1</sup>, 倉科 匡<sup>1</sup>, 細野秀美<sup>2</sup>, 杉本公一<sup>3</sup>, 原口啓樹<sup>1</sup> (大和電機工業, <sup>2</sup>甲南大学, <sup>3</sup>信州大学)</p> <p>5. 高密着性無電解めっきバリア膜の検討と TSV プロセスへの応用 ○西澤正一郎<sup>1</sup>, 井上史大<sup>2</sup>, 清水智弘<sup>1</sup>, 新宮原正三<sup>1</sup> (関西大学, <sup>2</sup>東北大学)</p>	<p><b>[2C3] JEITA 実装技術ロードマップ 2013 / 電子部品技術ロードマップ 2013 概要報告-1</b></p> <p>13:20 ~ 13:25</p> <p>1. はじめに 本多 進 (サーキットネットワーク)</p> <p>13:25 ~ 14:10</p> <p>2. 注目電子機器市場の動向 石井浩一 (TDK-EPC)</p> <p>14:10 ~ 14:55</p> <p>3. 世界をリードする主要電子部品技術の動向 (LCR, その他) 梶田 栄 (村田製作所)</p>	<p><b>[2D3] 配線基板・インターポータ</b></p> <p>1. 過熱水蒸気処理を用いた SAP 用基板の形成 ○八塚剛志, 伊藤千穂 (戸田工業)</p> <p>2. ダイレクトレーザービア行程において発生する銅オーバーハングの磁気研磨法による新規除去技術の検討 ○片山正彦<sup>1</sup>, 吉原佐知雄<sup>1</sup>, 清野正三<sup>2</sup>, 君塚亮一<sup>2</sup> (宇都宮大学大学院, <sup>2</sup>JCU 総合研究所)</p> <p>3. Cu 充填 Al 陽極酸化膜を応用した高密度配線基板の開発 ○松田勇一, 深澤 亮, 徳武安衛, 堀内道夫, 小林 壯 (新光電気工業)</p> <p>4. 微細化/高速化/薄型化を目指す次世代 B2HTM 配線基板技術の開発 ○福岡義孝<sup>1</sup>, 角田 剛<sup>2</sup>, 相楽秀次<sup>2</sup>, 戸井田剛<sup>3</sup> (ウェイスティン, <sup>2</sup>大日本印刷, <sup>3</sup>ナミック)</p> <p>5. セラミック回路基板における低温バイアス下での絶縁低下現象の解析 ○中村俊浩, 今田真嗣, 浅井康富, 大谷祐司 (デンソー)</p>
15:00	<p><b>[2A4] パワエレ-5 高耐熱接合 3</b></p> <p>1. 自動車におけるパワーエレクトロニクス製品の実装技術 ○石川岳史 (デンソー) (依頼講演 40分)</p> <p>2. Cu ナノ粒子接合のシミュレーションによる熱特性予測 ○柳瀬匡史<sup>1</sup>, 久野敦輝<sup>1</sup>, 田根 篤<sup>1</sup>, 大澤文明<sup>1</sup>, 山田 靖<sup>1</sup>, 石崎敏孝<sup>2</sup>, 佐藤敏一<sup>2</sup> (大同大学大学院, <sup>2</sup>豊田中央研究所)</p> <p>3. Cu ナノ粒子接合の熱特性評価 ○石崎敏孝<sup>1</sup>, 佐藤敏一<sup>1</sup>, 久野敦輝<sup>2</sup>, 田根 篤<sup>2</sup>, 柳瀬匡史<sup>2</sup>, 大澤文明<sup>2</sup>, 山田 靖<sup>2</sup> (豊田中央研究所, <sup>2</sup>大同大学)</p>	<p><b>[2B4] めっき技術-2</b></p> <p>1. 銅穴埋めめっきにおけるジアルルアミン系レベラーの側鎖の影響 ○山田康貴<sup>1</sup>, 竹内 実<sup>1</sup>, 岡本尚樹<sup>1</sup>, 齊藤丈靖<sup>1</sup>, 文屋 勝<sup>2</sup>, 横井昌幸<sup>1</sup>, 近藤和夫<sup>1</sup> (大阪府立大学大学院, <sup>2</sup>日東紡)</p> <p>2. 微小流路型反応器を用いた異種ハロゲンイオン存在下における PEG 吸着挙動の解析 ○辻本悠一, 宮本 豊, 岡本尚樹, 齊藤丈靖, 近藤和夫 (大阪府立大学大学院)</p> <p>3. PR パルスパラメータ制御によるビア内部の Cu 濃度分布とめっき形状の関係 ○林 太郎<sup>1</sup>, 竹内 実<sup>1</sup>, 横井昌幸<sup>1</sup>, 岡本尚樹<sup>1</sup>, 齊藤丈靖<sup>1</sup>, 近藤和夫<sup>1</sup>, 丸中正雄<sup>2</sup>, 土屋貴之<sup>2</sup>, 文屋 勝<sup>3</sup> (大阪府立大学, <sup>2</sup>新明和工業, <sup>3</sup>ニッターポーマディカル)</p> <p>4. 硫酸銅電めっき浴中の一価銅分析とめっき被膜の評価 ○古賀淑哲, 野間弘昭, 野中一洋 (産業技術総合研究所)</p> <p>5. Sn めっきによるピアフィリング ○堀 真雄, 佐藤琢朗, 松本守治, 時尾香苗, 福島敏明 (JCU)</p>	<p><b>[2C4] JEITA 実装技術ロードマップ 2013 / 電子部品技術ロードマップ 2013 概要報告-2</b></p> <p>15:05 ~ 15:50</p> <p>4. 低消費電力・高速デバイスの普及を支える IC パッケージング技術/変局点を迎えた我が国プリント配線板技術の動向 本多 進 (サーキットネットワーク)</p> <p>15:50 ~ 16:20</p> <p>5. 世界の実装現場を支える日本の実装設備 — 実装設備の技術動向 — 井上高宏 (パナソニック ファクトリーソリューションズ)</p> <p>16:20 ~ 16:50</p> <p>6. 電子回路のものづくりと検査技術 内山浩志 (富士ゼロックス)</p>	<p><b>[2D4] 信頼性技術</b></p> <p>1. ロックイン発熱解析を用いた故障解析ソリューション ○高森 圭, 山本 剣, 味岡恒夫, 中村隆治, 今井康雄 (沖エンジニアリング)</p> <p>2. 半導体パッケージ信頼性開発の簡易剥離試験の適用手法改善 ○草間竜一<sup>1</sup>, 于 強<sup>2</sup> (デンソー, <sup>2</sup>横浜国立大学)</p> <p>3. 電子デバイス実装部のエポキシ-シリコンゴム複合材料による応力低減効果 ○松嶋道也, 中島功康, 山内浩平, 西岡智志, 福本信次, 藤本公三 (大阪大学)</p> <p>4. 熱履歴を受ける樹脂の粘弾性特性変動を考慮した積層パッケージの反り解析 ○池田 徹<sup>1</sup>, 河原真哉<sup>2</sup>, 宮崎則幸<sup>2</sup>, 畑尾卓也<sup>3</sup> (鹿児島大学, <sup>2</sup>京都大学, <sup>3</sup>住友ベークライト)</p>
16:50				